

2010年4月28日

# 2010年3月期 決算説明会

代表取締役社長  
久芳 徹夫

京セラ株式会社

---

# 2010年3月期 通期業績

---

## 2010年3月期 通期業績

(単位:億円)

	2009年3月期		2010年3月期		前期比増減	
	金額	売上高比(%)	金額	売上高比(%)	金額	率(%)
売上高	11,286	100.0	10,738	100.0	-548	-4.9
営業利益	434	3.8	639	5.9	205	47.1
税引前当期純利益	560	5.0	608	5.7	48	8.6
当社株主に帰属する 当期純利益	295	2.6	401	3.7	106	35.9
希薄化後1株当たり当社株主に 帰属する当期純利益(円)	157.23	—	218.47	—	61.24	—
設備投資額	631	5.6	379	3.5	-252	-39.9
減価償却費	838	7.4	606	5.6	-232	-27.6
研究開発費	659	5.8	499	4.6	-160	-24.3

# 2010年3月期 決算要約

## 1. 主に円高の影響により前期比減収

		2009年3月期		2010年3月期	
平均為替レート		対ドル: 101円	対ユーロ: 143円	対ドル: 93円	対ユーロ: 131円
為替の変動による影響額(前期比)	売上高	約▲910億円		約▲490億円	
	税引前当期純利益	約▲230億円		約▲135億円	

## 2. 円高及び一時損失の影響はあったものの、原価低減等により前期比増益

**コスト削減の効果: 前期比**      約800億円

- ・ 労務費及び諸経費      約570億円
- ・ 減価償却費      約230億円

**ウィルコム関連の一時損失:** 約▲290億円

- ・ 株式の減損      約▲200億円
- ・ 売掛債権の貸倒損失      約▲90億円

## 2010年3月期 事業セグメント別売上高

(単位:億円)

■ 事業セグメント	2009年3月期		2010年3月期		前期比増減	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額	率 (%)
■ ファインセラミック部品関連事業	617	5.4	531	5.0	-86	-14.1
■ 半導体部品関連事業	1,351	12.0	1,405	13.1	54	4.0
■ ファインセラミック応用品関連事業	1,489	13.2	1,570	14.6	81	5.5
■ 電子デバイス関連事業	2,313	20.5	1,999	18.6	-314	-13.5
<b>部品事業 計</b>	<b>5,770</b>	<b>51.1</b>	<b>5,505</b>	<b>51.3</b>	<b>-265</b>	<b>-4.6</b>
■ 通信機器関連事業	2,188	19.4	1,891	17.6	-297	-13.5
■ 情報機器関連事業	2,293	20.3	2,324	21.6	31	1.3
<b>機器事業 計</b>	<b>4,481</b>	<b>39.7</b>	<b>4,215</b>	<b>39.2</b>	<b>-266</b>	<b>-5.9</b>
■ その他の事業	1,260	11.2	1,246	11.6	-14	-1.2
調整及び消去	-225	-2.0	-228	-2.1	-3	-
<b>売上高</b>	<b>11,286</b>	<b>100.0</b>	<b>10,738</b>	<b>100.0</b>	<b>-548</b>	<b>-4.9</b>

**部品事業・機器事業ともに減収**

## 2010年3月期 事業セグメント別事業利益

(単位:億円)

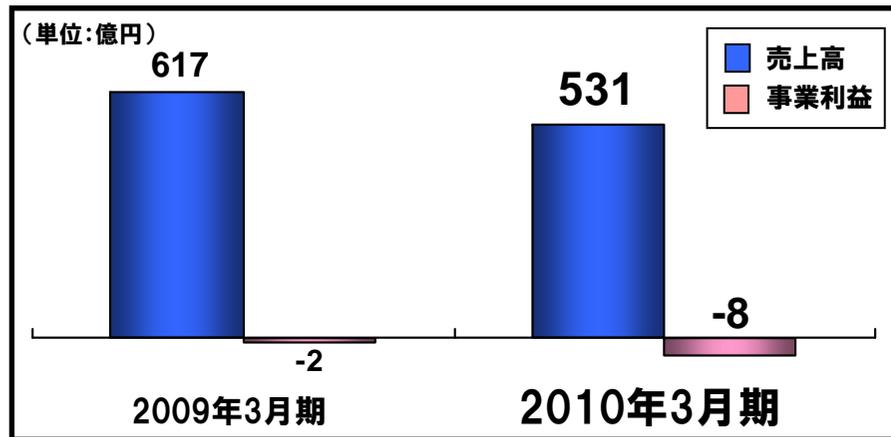
■ 事業セグメント	2009年3月期		2010年3月期		前期比増減	
	金額	利益率(%)	金額	利益率(%)	金額	率(%)
■ ファインセラミック部品関連事業	-2	-	-8	-	-6	-
■ 半導体部品関連事業	86	6.4	172	12.3	86	98.8
■ ファインセラミック応用品関連事業	275	18.4	199	12.6	-76	-27.7
■ 電子デバイス関連事業	-41	-	132	6.6	173	-
<b>部品事業 計</b>	<b>318</b>	<b>5.5</b>	<b>495</b>	<b>9.0</b>	<b>177</b>	<b>55.5</b>
■ 通信機器関連事業	-177	-	-147	-	30	-
■ 情報機器関連事業	135	5.9	221	9.5	86	63.7
<b>機器事業 計</b>	<b>-42</b>	<b>-</b>	<b>74</b>	<b>1.7</b>	<b>116</b>	<b>-</b>
■ その他の事業	141	11.2	68	5.4	-73	-52.0
<b>事業利益 計</b>	<b>417</b>	<b>3.7</b>	<b>637</b>	<b>5.9</b>	<b>220</b>	<b>52.6</b>
本社部門損益等	143	-	-29	-	-172	-
<b>税引前当期純利益</b>	<b>560</b>	<b>5.0</b>	<b>608</b>	<b>5.7</b>	<b>48</b>	<b>8.6</b>

**部品事業・機器事業ともに大幅な増益**

# 2010年3月期 事業セグメント別業績推移 (1)

## ファインセラミック部品関連事業

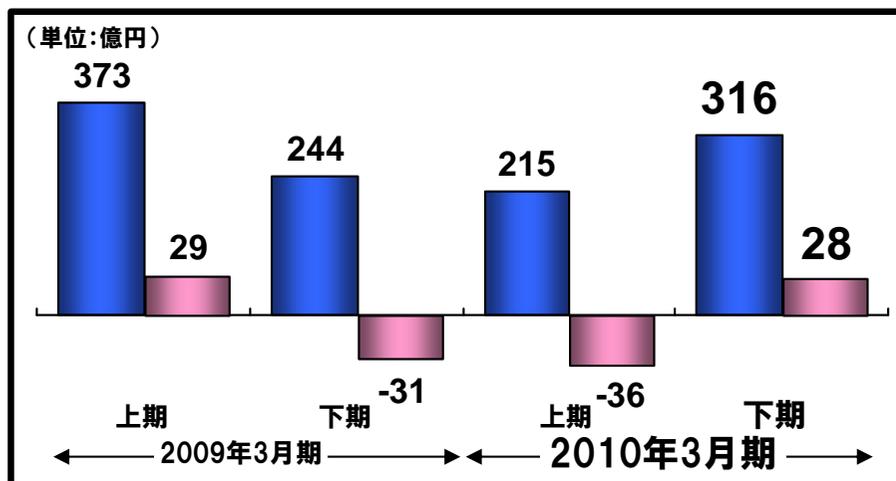
### 通期



#### 2009年3月期比

- 情報通信、産業機械、自動車産業市場での生産活動の低迷により減収減益

### 半期別推移



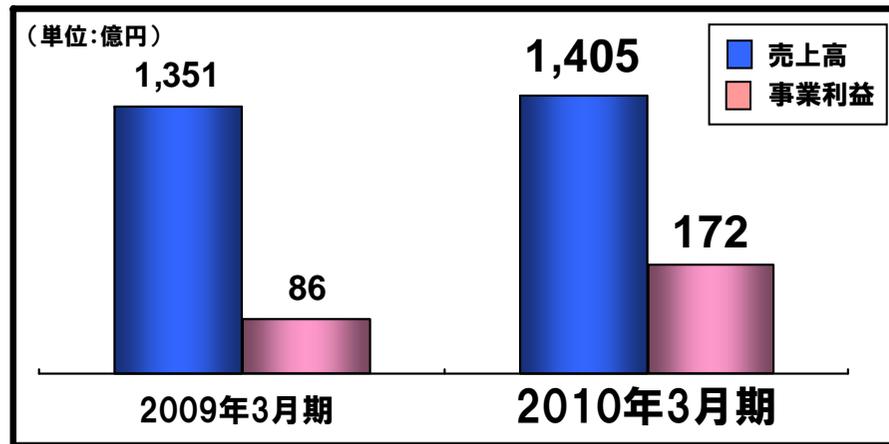
#### 2010年3月期下期概況 (上期比)

- 情報通信用部品に加え、産業機械用部品、自動車用部品の需要回復により大幅な増収
- 増収及び原価低減により、大幅に収益性が改善

## 2010年3月期 事業セグメント別業績推移（2）

### 半導体部品関連事業

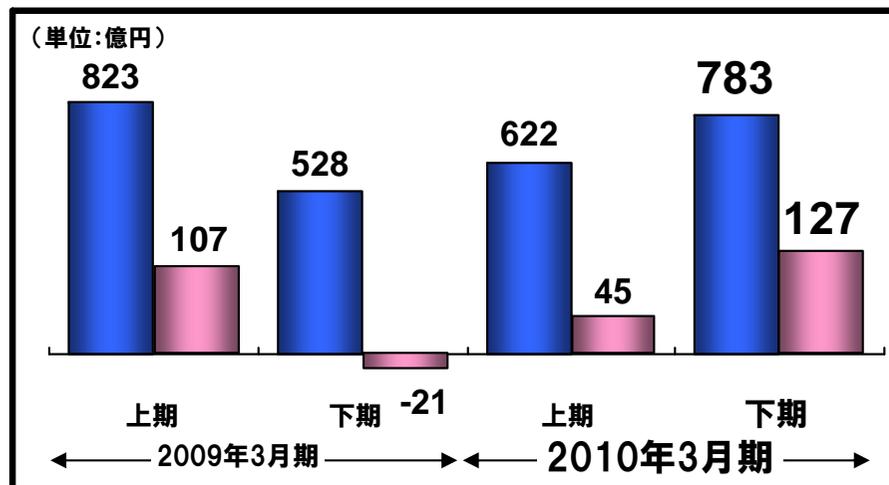
#### 通期



#### 2009年3月期比

- デジタルコンシューマ機器向けパッケージの需要回復により増収
- 原価低減の効果により大幅な増益

#### 半期別推移



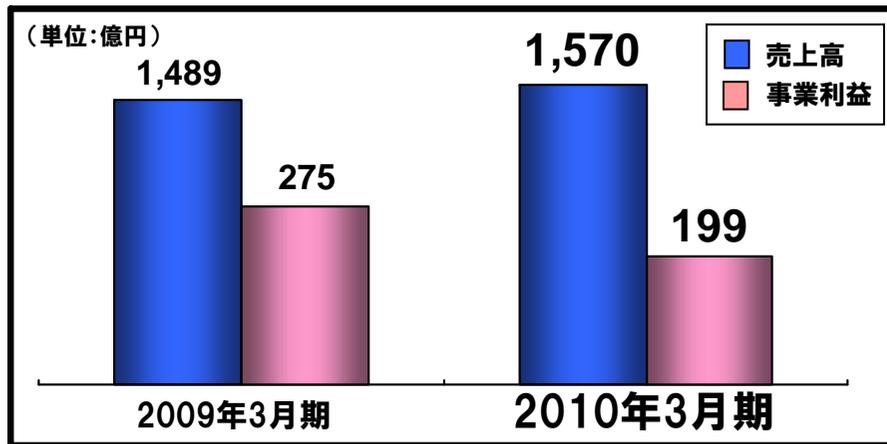
#### 2010年3月期下期概況（上期比）

- デジタルコンシューマ機器向け部品の旺盛な需要により増収
- 増収及び生産性向上により大幅な増益

## 2010年3月期 事業セグメント別業績推移（3）

### ファインセラミック応用品関連事業

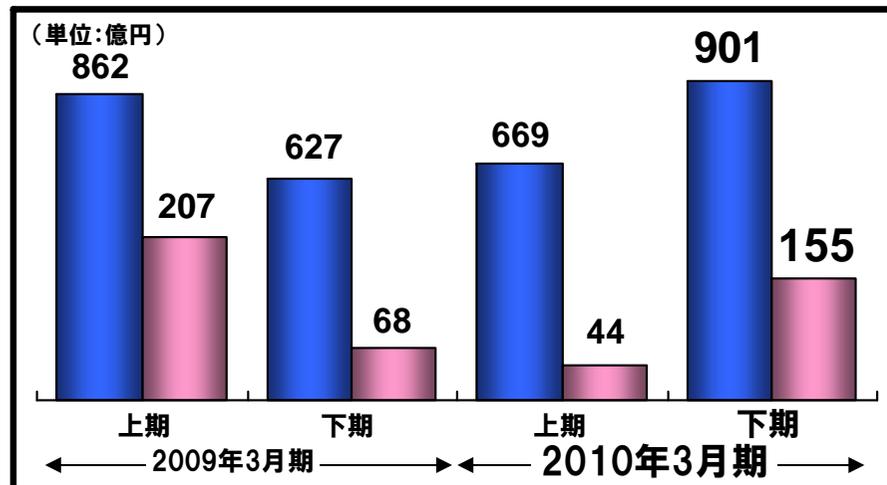
#### 通期



#### 2009年3月期比

- 国内市場を中心としたソーラーエネルギー事業の拡大により増収
- 円高及び海外での太陽電池価格の下落、機械工具市場の低迷により減益

#### 半期別推移



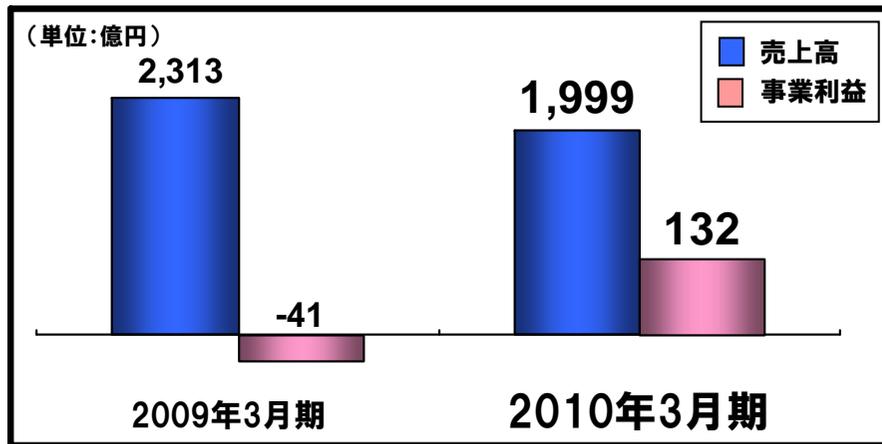
#### 2010年3月期下期概況（上期比）

- ソーラーエネルギー事業の拡大に加え、機械工具事業での需要回復により収益向上

# 2010年3月期 事業セグメント別業績推移（4）

## 電子デバイス関連事業

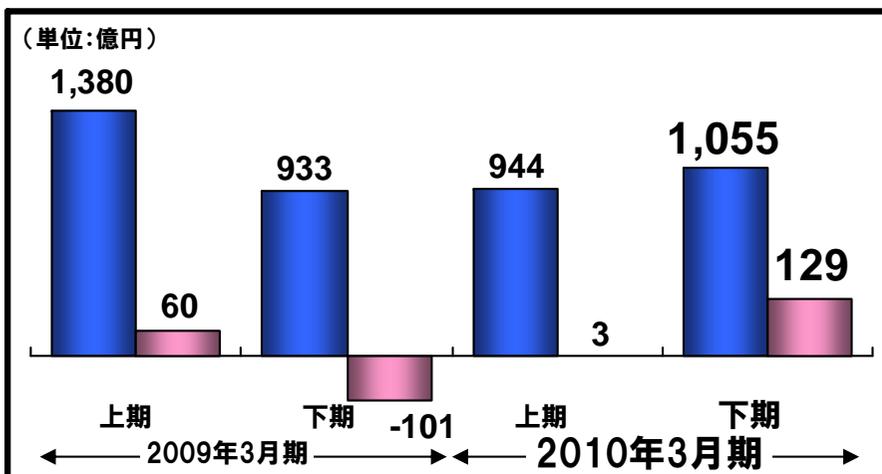
### 通期



#### 2009年3月期比

- 需要の回復は見られたものの、売上高は前期の水準には至らず
- 製造工法の見直しなどの原価低減の効果により、事業利益は大幅に改善

### 半期別推移



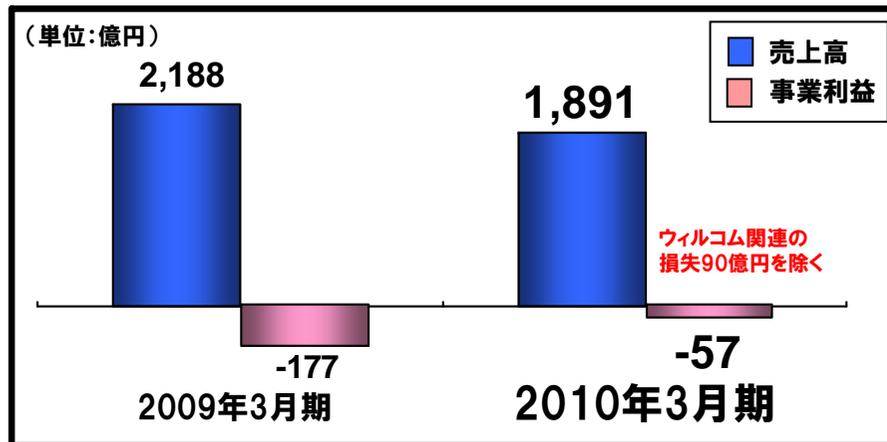
#### 2010年3月期下期概況（上期比）

- デジタルコンシューマ機器向け部品の旺盛な需要により増収
- 増収や原価低減の効果、生産性の向上により、収益性は大幅に改善

# 2010年3月期 事業セグメント別業績推移 (5)

## 通信機器関連事業

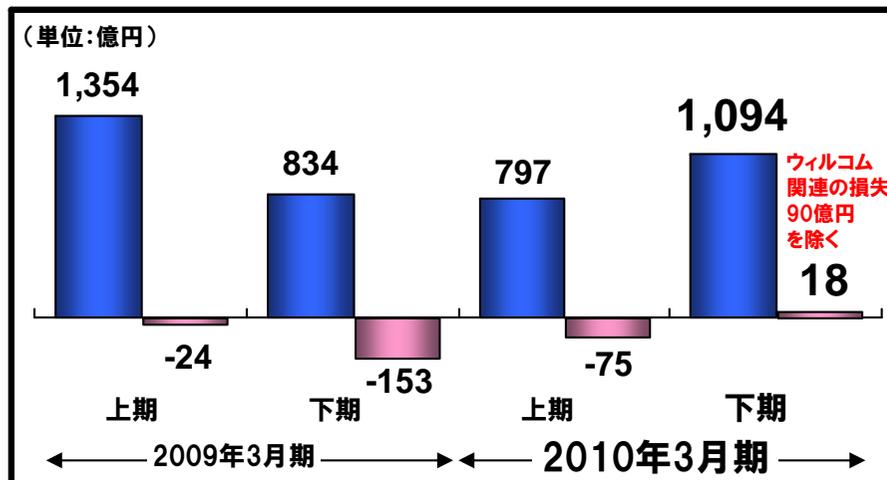
### 通期



#### 2009年3月期比

- 北米及び国内での携帯電話端末の販売減少により減収
- 開発及び販売組織再編などによるコスト削減により損失縮小

### 半期別推移



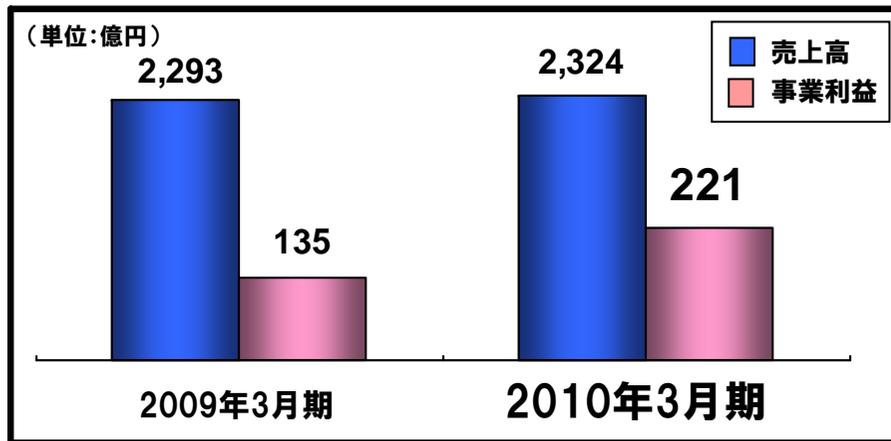
#### 2010年3月期下期概況 (上期比)

- 国内、海外市場での新モデルの増加及び海外での新規客先の開拓により増収
- 増収及び原価低減によりウィルコム関連の損失約▲90億円を除くと下期は黒字

# 2010年3月期 事業セグメント別業績推移 (6)

## 情報機器関連事業

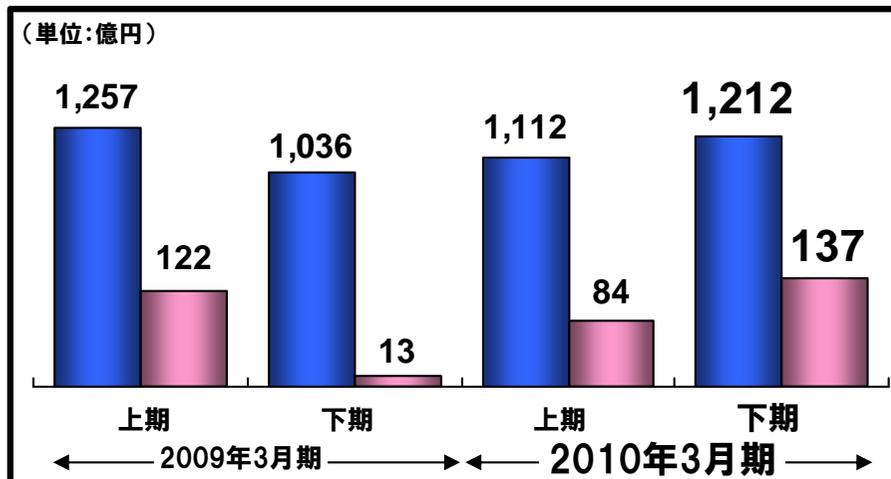
### 通期



#### 2009年3月期比

- 円高や世界的な情報化投資の抑制はあったものの、新規子会社の貢献により、売上高は微増
- 原価低減の効果により増益

### 半期別推移



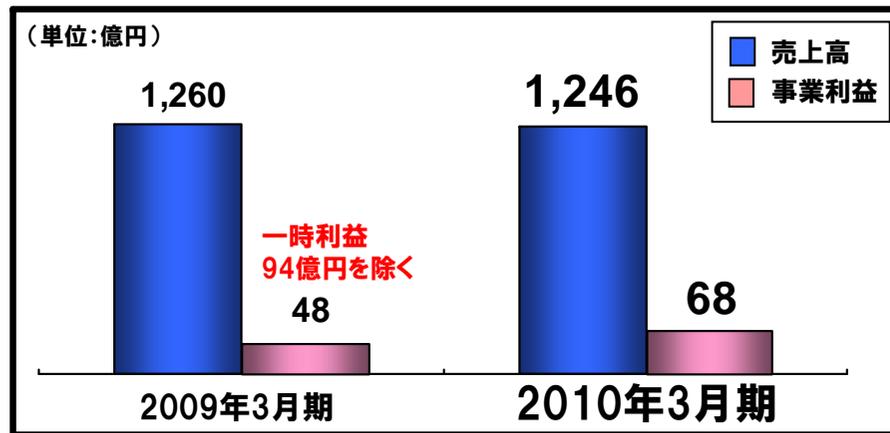
#### 2010年3月期下期概況 (上期比)

- 緩やかな市場の回復により増収
- カラー製品の販売増及び原価低減により増益

# 2010年3月期 事業セグメント別業績推移 (7)

## その他の事業

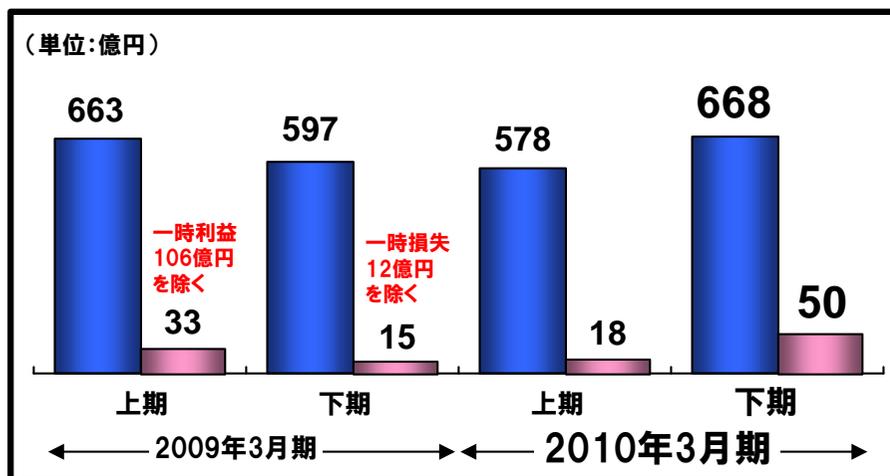
### 通期



#### 2009年3月期比

- 京セラコミュニケーションシステム以外の子会社の売上が景気低迷により減少
- 前期の固定資産売却損益約94億円を除くと、原価低減により実質的には増益

### 半期別推移



#### 2010年3月期下期概況 (上期比)

- 京セラコミュニケーションシステムと京セラケミカルの売上増加により増収増益

## 2010年3月期の取組みと成果

**課題： 早急な収益性の改善と各事業の経営基盤の強化**

### 主な取組み

### 成果

#### 徹底したコスト削減の推進



期初予想（前期比▲560億円）を大きく  
上回るコスト削減を実施  
前期比： 約800億円

#### 通信機器関連事業の収益改善

- 米国販売会社設立による拡販
- KWI売却による固定費の削減
- 開発及び製造コストの低減
- 下期における新製品投入拡大



通信機器関連事業の下期黒字化  
（一時損失を除く）

#### ソーラーエネルギー事業の拡大

- 生産能力拡大と販売網の拡充



- 生産量を前期比約40%増となる400MWに拡大
- 日米欧各拠点での販売網をそれぞれ約100社に拡充

# 2011年3月期 業績予想

---

## 2011年3月期 通期業績予想

(単位:億円)

	2010年3月期		2011年3月期 予想		前期比増減	
	金額	売上高比(%)	金額	売上高比(%)	金額	率(%)
売上高	10,738	100.0	12,000	100.0	1,262	11.8
営業利益	639	5.9	1,220	10.2	581	91.0
税引前当期純利益	608	5.7	1,320	11.0	712	117.1
当社株主に帰属する 当期純利益	401	3.7	850	7.1	449	112.0
希薄化後1株当たり当社株主に帰属する 当期純利益(円)	218.47	—	463.15	—	244.68	—
設備投資額	379	3.5	600	5.0	221	58.4
減価償却費	606	5.6	700	5.8	94	15.5
研究開発費	499	4.6	600	5.0	101	20.2
平均為替レート	対ドル	対ユーロ	対ドル	対ユーロ		
	93円	131円	90円	120円		

(注1) 2011年3月期業績予想の希薄化後1株当たり当社株主に帰属する当期純利益は、2010年3月期の希薄化後の期中平均発行済株式数を用いて算出しています。

## 2011年3月期 事業セグメント別 売上高予想

(単位:億円)

■ 事業セグメント	2010年3月期		2011年3月期予想		前期比増減	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	金額	率(%)
■ ファインセラミック部品関連事業	531	5.0	640	5.3	109	20.6
■ 半導体部品関連事業	1,405	13.1	1,580	13.2	175	12.4
■ ファインセラミック応用品関連事業	1,570	14.6	2,010	16.8	440	28.0
■ 電子デバイス関連事業	1,999	18.6	2,170	18.1	171	8.5
<b>部品事業 計</b>	<b>5,505</b>	<b>51.3</b>	<b>6,400</b>	<b>53.4</b>	<b>895</b>	<b>16.3</b>
■ 通信機器関連事業	1,891	17.6	2,000	16.7	109	5.8
■ 情報機器関連事業	2,324	21.6	2,430	20.2	106	4.6
<b>機器事業 計</b>	<b>4,215</b>	<b>39.2</b>	<b>4,430</b>	<b>36.9</b>	<b>215</b>	<b>5.1</b>
■ その他の事業	1,246	11.6	1,420	11.8	174	14.0
調整及び消去	-228	-2.1	-250	-2.1	-22	-
<b>売上高</b>	<b>10,738</b>	<b>100.0</b>	<b>12,000</b>	<b>100.0</b>	<b>1,262</b>	<b>11.8</b>

## 2011年3月期 事業セグメント別 事業利益予想

(単位:億円)

■ 事業セグメント	2010年3月期		2011年3月期予想		前期比増減	
	金額	利益率(%)	金額	利益率(%)	金額	率(%)
■ ファインセラミック部品関連事業	-8	-	100	15.6	108	-
■ 半導体部品関連事業	172	12.3	250	15.8	78	45.1
■ ファインセラミック応用品関連事業	199	12.7	290	14.4	91	46.0
■ 電子デバイス関連事業	132	6.6	280	12.9	148	111.6
<b>部品事業 計</b>	<b>495</b>	<b>9.0</b>	<b>920</b>	<b>14.4</b>	<b>425</b>	<b>85.7</b>
■ 通信機器関連事業	-147	-	60	3.0	207	-
■ 情報機器関連事業	221	9.5	221	9.1	0	0.0
<b>機器事業 計</b>	<b>74</b>	<b>1.7</b>	<b>281</b>	<b>6.3</b>	<b>207</b>	<b>281.5</b>
■ その他の事業	68	5.4	78	5.5	10	15.2
<b>事業利益 計</b>	<b>637</b>	<b>5.9</b>	<b>1,279</b>	<b>10.7</b>	<b>642</b>	<b>100.9</b>
本社部門損益等	-29	-	41	-	70	-
<b>税引前当期純利益</b>	<b>608</b>	<b>5.7</b>	<b>1,320</b>	<b>11.0</b>	<b>712</b>	<b>117.1</b>

## 2011年3月期 業績予想要約

### 1. 事業環境の改善と成長機会を捉えた事業拡大により 増収増益を見込む

- 部品事業、機器事業ともに増収増益を予想

### 2. 旺盛な需要獲得に向けた設備投資の実施

- 半導体部品関連事業、ソーラーエネルギー事業での生産能力増強

### 3. 一時損失の減少

- 2010年3月期： 約▲290億円

### 4. 米ドル・ユーロに対する円高の影響

- 2010年3月期比 売上高： 約▲410億円  
税引前当期純利益： 約▲130億円

## 2011年3月期 業績予想達成のための重点課題

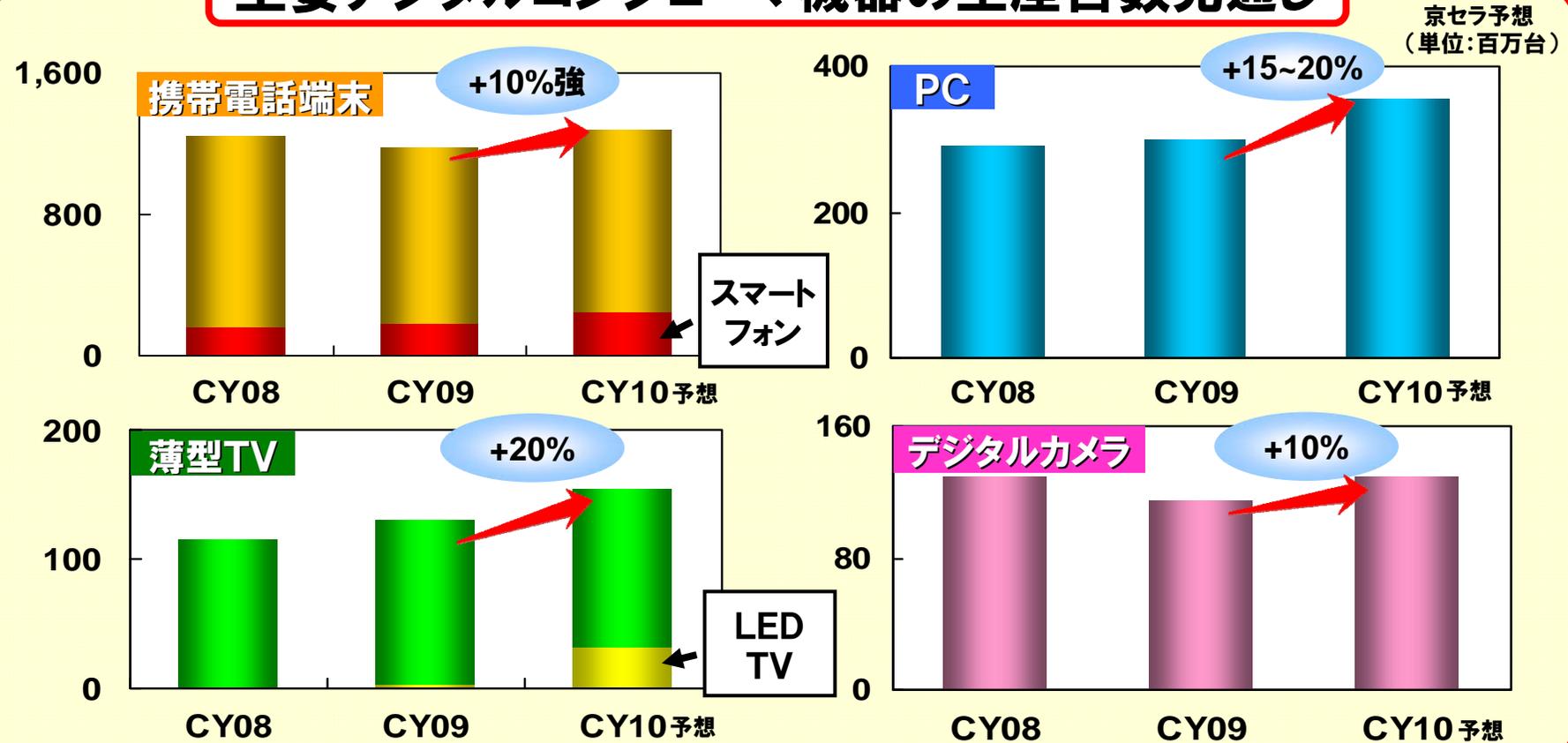
**電子デバイス関連事業の収益性向上**

**通信機器関連事業の収益性向上**

**ソーラーエネルギー事業の売上拡大**

# 電子デバイス関連事業の収益性向上（1）

## 主要デジタルコンシューマ機器の生産台数見通し



2011年3月期の事業環境は前期に比べ改善

## 電子デバイス関連事業の収益性向上（2）

### 1. 新興国での売上拡大

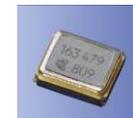
- 需要の拡大が見込まれる中国市場への拡販

### 2. 積極的な新製品投入による売上拡大

- 小型・高容量コンデンサのラインナップの拡充
- 小型・高精度水晶関連製品の拡大  
(TCXO、音叉型水晶振動子)



コンデンサ



TCXO



水晶振動子

### 3. 製造原価の低減及び生産性の向上

- 製造工法の見直し継続及び各種製品への水平展開
- 高性能材料の開発による原価低減

# 通信機器関連事業の収益性向上

2010年3月期

2011年3月期

事業体質の強化

一時損失を除き下期黒字化

## さらなる事業体質の強化

- 国内事業と海外事業の体制強化
- KWCの統合による開発と製造管理体制の国内集約

## 販売の拡大

### 従来市場(日本、米国)

- 米国でのスマートフォンを含む製品ラインナップの強化
- 継続的な新製品投入

### 新市場(中南米)

- GSM/UMTS端末の投入

通期黒字化

# ソーラーエネルギー事業の拡大（１）

## - 2011年3月期 市場見通し -

### 世界市場規模

- 政策主導型市場拡大
- 保守的見通し

2010年3月期（予想）

2011年3月期（予想）

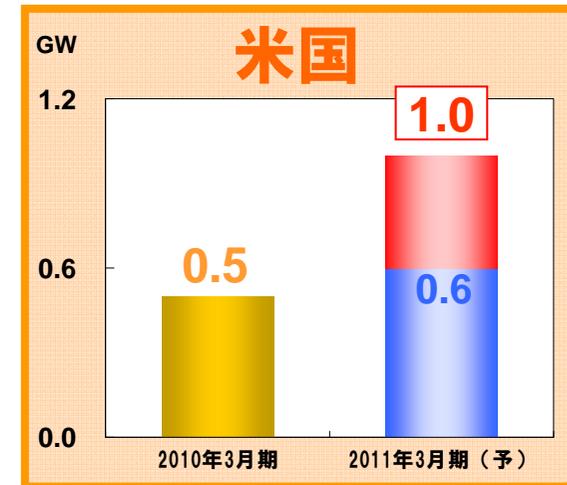
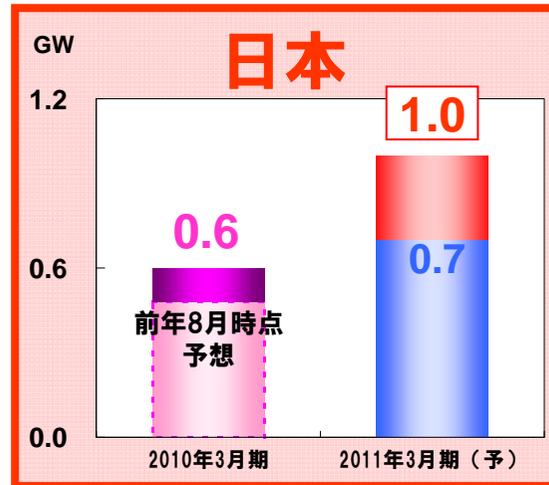
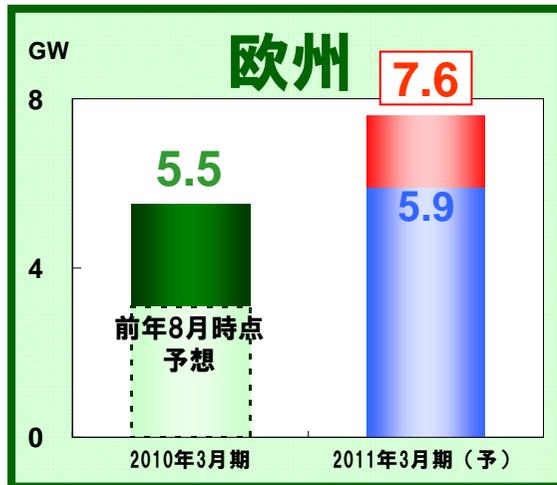
7.2GW

→ 11.0GW (+50%) : 政策主導型市場拡大

→ 7.9GW (+10%) : 保守的見通し

\*カッコ内は直前期比伸び率

## 2011年3月期の市場は堅調に拡大



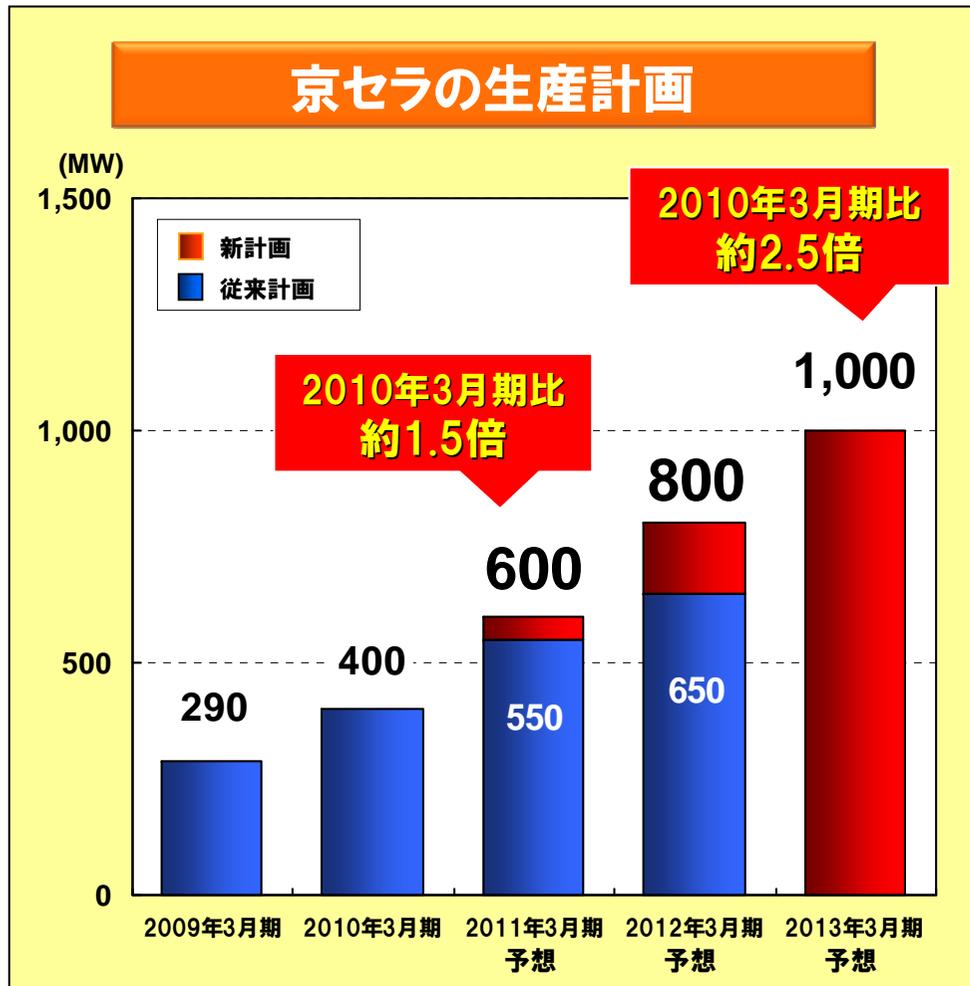
- ドイツ、フランス、イタリア市場の拡大

- 補助金及び電力買取制度による住宅向け需要が堅調に増加

- グリーンニューディール政策効果が今期から本格貢献

# ソーラーエネルギー事業の拡大（２）

## -生産計画と増産に向けた取組み-



### 新工場の稼働によるセル生産拡大



滋賀野洲新工場

2010年夏頃  
生産開始予定

### 各拠点でのモジュール生産拡大

- 生産拠点の拡大  
サンディエゴ工場（2010年夏頃稼働予定）
- 世界4拠点での生産能力増強



三重伊勢工場



メキシコ工場



チェコ工場



中国新工場

（2010年秋頃  
完成予定）

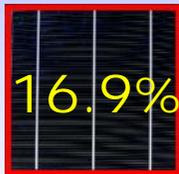
# ソーラーエネルギー事業の拡大（3）

## -売上拡大に向けた取組み-

### 結晶系太陽電池の優位性を活かした販売促進

#### 高い変換効率とモジュール出力

- 薄膜型に比べ高い変換効率

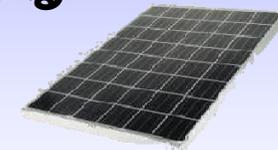


- さらなるモジュールの大型化



#### 長期信頼性

- 25年間稼働し続けているモジュールにて実証



#### 大型案件の獲得事例



扇島太陽光発電所  
仮称/完成イメージ  
(東京電力様: 13MW)

## 2011年3月期 経営目標

2011年3月期

**成長機会を確実に捉え、売上高2桁増、  
税引前利益2倍以上を目指す**

**重点課題**

**電子デバイス関連事業の収益性向上**

**通信機器関連事業の収益性向上**

**ソーラーエネルギー事業の売上拡大**

**2010年3月期： 各事業の経営基盤の強化**

## 将来予想に関する注意事項

この資料に記載されている記述には、1934年米国証券取引所施行21E条に定義される「将来予想に関する記述」(forward-looking statements)が含まれています。これらの将来予想に関する記述は、現時点で入手できる情報に鑑みて当社が予想を行い、所信を表明したものであります。これらの将来予想に関する記述は、既知及び未知のリスク、不確実な要因並びにその他の要因を含んでいます。これらのリスク、不確実な要因及びその他の要因は以下のものを含みますが、これらに限られるものではありません。(1)当社が関連する市場における経済状況(主に、日本、北米、欧州並びにアジア(特に中国))。(2)中国における経済・政治・法律面での条件の予測し得ない変化。(3)競争の激しいセラミック、半導体部品及び電子部品市場において当社が、革新的な製品を開発・生産し、品質・納期を含めて、顧客の要求に沿った先進技術を投入する能力の不確実性。(4)生産高や業績に影響を与える社外委託工程や自社内製造過程で生じる遅れや不具合の発生。(5)円高、政治・経済情勢、売掛金回収リスク、製品の価格競争力の低下、輸送経費の増大、海外事業への人材配置・管理の問題、知的財産権の保護の不十分性など、輸出に影響する可能性がある要素。(6)売上高の相当な部分を構成している通貨(特に米ドル及びユーロ)の対円為替相場の変動。(7)当社顧客の財政状態の悪化による売掛債権の回収リスク。(8)エンジニアリング・技術部門での熟練労働者の確保の不確実性。(9)機密保持及び特許権の保護の確保が不十分である事態。(10)製品を製造・販売する為に必要となるライセンスの継続的確保の不確実性。(11)今後の取り組み及び現在進行中の研究開発が期待される成果を生み出さない事態。(12)買収した会社や取得した資産に関連して想定以上の統合費用がかかり、期待される収益又は事業機会が得られない事態。(13)テロ行為、疾病の発生など、当社の市場やサプライチェーンに悪影響を与える要素。(14)製造施設その他主要な事業関連施設が存在する地域における地震などの自然災害の発生。(15)国内外の環境規制強化に伴う当社の賠償責任や遵守義務の増大。(16)保有する有価証券及びその他の資産の時価の変動、減損処理の発生。(17)会計基準の変更。これらのリスク、不確実な要因及びその他の要因により、当社の実際の業績、事業活動、展開又は財務状況は、これらの将来予想に関する記述に明示又は包含される将来の業績、事業活動、展開又は財務状況と大きく異なる場合があります。当社は、この資料に記載されている将来予想に関する記述についてこれらの内容を更新し公表する責任を負いません。